

#### 4-3 「S/P温度制御」(SP/T)

##### 1. 「S/P水温制御」(SP/T(W))

###### (1) 目的

本制御の目的は、S/P水温度を監視し制御することである。

###### (2) 導入条件

- ・「スクラム」(RC)においてSRV開固着の場合。
- ・「スクラム」(RC)の「格納容器制御への導入」において、S/P水のバルク温度が[32℃(通常運転制限温度)]以上の場合。

###### (3) 操作のポイント

S/P水温度が43℃に到達したら、速やかに手動スクラムし減圧する。

###### (4) 脱出条件

- ・S/P水温(バルク温度)が24時間以内に32℃以下となった場合。(監視強化)
- ・S/P水温(バルク温度)が43℃以上(スクラム制限温度)で手動スクラムを実施した場合。

##### 2. 「S/P空間部温度制御」(SP/T(A))

###### (1) 目的

本制御の目的は、S/P空間部の温度を監視し制御することである。

###### (2) 導入条件

- ・「スクラム」(RC)の「格納容器制御への導入」において、S/P空間部の局所温度が[43℃]以上の場合。

###### (3) 操作のポイント

S/P空間部温度はS/P水温度のバックアップ的意味合いをもつものであり、S/P空間部温度だけが上昇するような場合には、異常事態が生じた可能性があるため早期に対応操作を行うこと。

S/P空間部温度を下げるために、空間部温度が138℃(S/P設計温度)に到達する前にS/Pスプレーを作動させる。

###### (4) 脱出条件

- ・S/P空間部(局所)温度が43℃未満となった場合。(監視強化)
- ・S/P水温度(バルク)が43℃以上で、手動スクラムを実施した場合。







